

【新闻发布】 【2023 年 3 月 22 日】

广濑电机推出了最大可支持 112Gbps PAM4 的板对板连接器「IT14」系列。

- 采用 OCP 加速器模块 (OAM) 标准的连接器
作为美国 Molex「Mirror Mezz」的第二供应商产品，支持稳定供应-

广濑电机推出了最大可支持 112Gbps PAM4 传输速度的雌雄同形板对板连接器「IT14」系列。该产品是连接器制造商 Molex（总部：美国伊利诺伊州莱尔，以下简称：Molex）于 2018 年为服务器，数据通信，电信设备等应用开发的 Mirror Mezz^{*1} 的正式第二供应商产品。



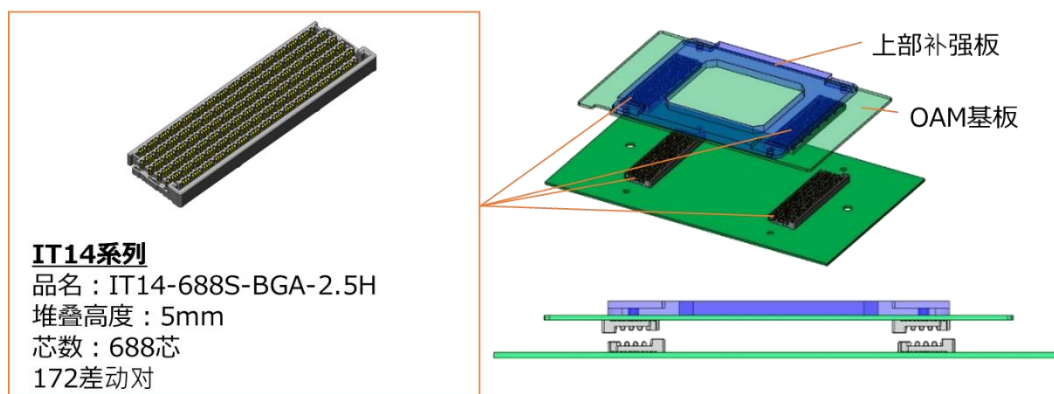
● 通信设备市场所需部件的稳定供应

「IT14」系列产品主要是为了满足通信设备市场对供应商的稳定供应需求而推出的。开放计算项目 (OCP)^{*2} 加速器模块 (OAM, OCP 加速器模块) 采用 Molex 的 Mirror Mezz 的板对板连接器，它也被应用在大型半导体制造商的 ASIC (Application Specific Integrated Circuit, 专用集成电路) 和 GPU (Graphics Processing Unit, 图形处理器) 的芯片组等的连接。

● 出色的传输性能和操作性

「IT14」系列可支持最大 112Gbps PAM4 / 56Gbps NRZ 的高速传输。连接器是雌雄同形的设计，可以减少各个基板的设计工时。此外，通过在每个引脚排列中使用外壳保护端子前端的构造，在防止咬合时端子屈曲的同时，可以实现盲配合，所以操作性很好。

OCP Accelerator Module (OAM) 使用示例



Molex 公司 Mirror Mezz 的第二供应商产品:IT14

1. 支持高速传输（对应 112Gbps PAM4 / 56Gbps NRZ）
2. 适合 OAM 标准的连接器
3. 多芯高密度设计：688 芯（172 差分对）
4. 雌雄同形设计
5. 无短线柱双触点构造

● 关于今后产品的展开

这次发布的「IT14」系列是可以满足数据通信，电信设备等需求的产品。目前，提供以下选型：

- 堆叠高度：5m
- 芯数：688 芯

广濑电机今后也将满足多样化的连接需求，为设备的发展做出贡献。

● 公司概况、相关信息

- 公司概况 https://www.hirose.com/corporate/ja/about/corporate_data/
- 关于 IT14 系列
 - 特辑页面 <https://www.hirose.com/zh/product/pr/IT14/>
 - 产品页面 <https://www.hirose.com/product/series/IT14/>
 - 产品视频 <https://prd-4s-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sys-master/public/hcd/h05/9240371331102/IT14.png>

^{*1} Molex 和 Mirror Mezz 是 Molex、LLC 美国和/或其他国家的注册商标或商标。

^{*2} 开放计算项目：2011 年 4 月，Facebook（现为 Meta）倡导可扩展的计算，提供高效的服务器，存储和数据中心等硬件设计的工程师社区。